

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2020/094320 A1

(43) Date de la publication internationale
14 mai 2020 (14.05.2020)

WIPO | PCT

(51) Classification internationale des brevets :
G06K 19/077 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2019/077275

(22) Date de dépôt international :
09 octobre 2019 (09.10.2019)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1860297 08 novembre 2018 (08.11.2018) FR

(71) Déposant : SMART PACKAGING SOLUTIONS
[FR/FR] ; 85 avenue de la Plaine - ZI de Rousset, 13790
ROUSSET (FR).

(72) Inventeurs : CALVA, Bernard ; chez SMART PACKAGING SOLUTIONS 85 avenue de la Plaine - ZI de Rousset, 13790 ROUSSET (FR). VOLPE, Pierre ; chez SMART PACKAGING SOLUTIONS 85 avenue de la Plaine - ZI de Rousset, 13790 ROUSSET (FR).

(74) Mandataire : DUDOUIT, Isabelle et al. ; MARKS & CLERK FRANCE, Immeuble Visium, 22, avenue Aristide Briand, 94117 ARCUEIL Cedex (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,

(54) Title: ELECTRONIC MODULE FOR CHIP CARD

(54) Titre : MODULE ELECTRONIQUE POUR CARTE A PUCE

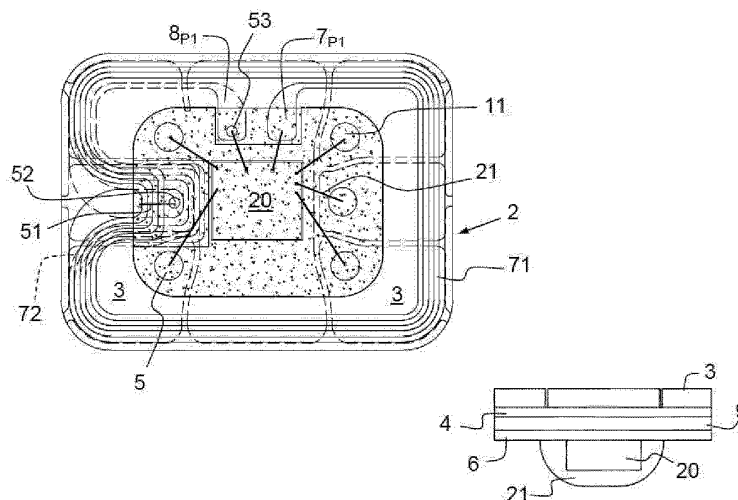


FIG.10

(57) Abstract: Process for producing an electronic module that is intended for implementation in a dual portable object, characterized in that it includes at least the following steps: • Using a single-sided film (4) consisting of one or more contact zones (3) and a dielectric comprising one or more openings; • Using a substrate (6) comprising one or more electrically conductive zones that are intended for the contactless communication of the object; • Fixing said single-side film (4) and said substrate (6) together; • Positioning an integrated circuit (20) and connecting it to the contact zones (3) of the single-sided film and at least one terminal of at least one of said electrically conductive zones; • Depositing a protective layer (21) surrounding at least said integrated circuit. Module obtained by means of the process.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'un module électronique destiné à être implémenté dans un objet portable dual caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes : • Utiliser un film simple face (4) constitué par une ou plusieurs zones de contacts (3) et un diélectrique comprenant un ou plusieurs orifices, • Utiliser un substrat (6) comprenant une ou plusieurs zones électriquement conductrices destinées à la communication sans contact de l'objet, • Solidariser ledit film simple face (4) et ledit substrat (6), • Positionner

[Suite sur la page suivante]

WO 2020/094320 A1

PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

un circuit intégré (20) et le connecter aux zones de contacts (3) du film simple face et au moins à une borne d'au moins une desdites zones électriquement conductrices, • Déposer une couche de protection (21) englobant au moins ledit circuit intégré. Module obtenu par le procédé.